

PICOSUN™ P-300BV

PICOSUN™ P-300BV ALDシステムは、LED、ディスプレイデバイス、およびプリントヘッド、センサー、マイクなどのMEMSデバイスの生産に最適な装置です。



技術的特長

PICOSUN™ P-300BV ALDシステムは、大量生産用ALDの新しい標準となっています。特許取得済みのホットウォール設計と完全に分離したプリカーサ注入口を組み合わせることにより、優れた歩留まり、低パーティクルレベル、優れた電気的および光学的性能を備えた最高品質のALD膜を作り出すことができます。簡単かつ迅速なメンテナンスを備えたアジャイルな設計により、システムのダウンタイムを最小限に抑え、市場での所有コストを最小限に抑えることができます。当社独自のPicoflow™ディフュージョンエンハンサ技術により、生産実績のあるプロセスで、超高アスペクト比の基板にも非常に付回りの良いコーティングができます。

PICOSUN™ P-300BV ALDシステムは、産業ALDの最先端を代表する製品です。このシステムは、ウエハバッチをセミオートでハンドリングする設計になっています。このツールは高速バッチ生産用に最適化されており、SECS / GEMオプションを介してファクトリオートメーションに統合できます。ヒーティングオプション付きの真空ローディングシステムによりクリーン度の高い処理、またダメージを受けやすい基板や金属窒化物などの繊細な材料の成膜が可能になります。

PICOSUN™ P-300BV は、イノベーションを目指す業界で選ばれているALDシステムです。

標準的な基板サイズと種類

- 200 mmウエハでバッチあたり25枚 (標準ピッチ)
- 150 mmウエハでバッチあたり50枚 (標準ピッチ)
- 100 mm ウエハでバッチあたり75枚 (標準ピッチ)
- 非ウエハ基板 (特注ホルダー)
- 高アスペクト比サンプル(1:2500~)

処理温度

- 50~450°C

標準プロセス

- 最小一桁秒のサイクルタイムでバッチ処理が可能*
- Al_2O_3 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Ta_2O_5 、 HfO_2 、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiN 、 AlN 、およびメタル
- バッチ成膜の1 σ 不均一性 < 1% (Al_2O_3 、面内・ウエハ間・バッチ間、49点測定、EE:5mm)**

基板ローディング

- パーティカルローダー (1台または2台) によるセミオートローディング
- オプション: ロードロック用ヒーター

プリカーサ

- 液体、固体、気体、オゾン
- レベルセンサ (オプション)
- 4カ所に分かれた注入口から最大8種のソース

* サイクル時間 < 10秒

** 面内不均一性 < 1%

詳細な情報をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

picosun
AGILE ALD